



高通公司新建大樓落成 扎根竹科半導體產業聚落

New Building of Qualcomm Was Completed-Solidifying the Semiconductor Industry Cluster at the Hsinchu Science Park

クアルコムオフィスビル落成、新竹サイエンスパーク半導体産業クラスター参入

文・圖／投資組 黃以晴

美商高通公司於 2023 年 3 月 17 日在新竹科學園區舉行新建大樓落成典禮，此大樓為高通總部之外的首座自建大樓，邀請科管局王永壯局長致詞及美國在臺協會孫曉雅處長、經濟部技術處邱求慧處長、工業局陳佩利副局長、國發會產業發展處詹方冠處長、國科會工程處李志鵬處長到場共襄盛舉。大樓內建置包括營運與製造工程暨測試中心及 5G 測試實驗室、多媒體研發中心、行動人工智慧創新中心等三大研發中心，未來將與臺灣資通訊業者合作進入新里程碑，邁向全球 5G 時代來臨。

高通集團為全球無線晶片與手機處理器開發之領導廠商，全球員工超過 4.5



科管局王永壯局長致詞

萬人，2021 年營業額高達 335 億美元，擁有專利超過 16 萬件；未來萬物聯網，全球企業將加速數位轉型，高通公司未



由左至右與會嘉賓:工業局陳佩利副局長、高通公司臺灣、東南亞與紐澳區劉思泰總裁、國科會工程處李志鵬處長、經濟部技術處邱求慧處長、高通公司陳若文副總裁、美國在臺協會孫曉雅處長、國發會產業發展處詹方冠處長、高通公司Sudepto Roy副總裁、科管局王永壯局長

來將朝向車聯網、遠端健康醫療服務、智慧城市、智慧家庭、穿戴裝置等物聯網領域創新發展，期待結合竹科的創新能量和群聚效應，加速研發腳步、深化產業合作，協助人才培育與臺灣自主研发能力的提升，帶動臺灣行動通訊產業的快速發展。

高通公司於竹科新建的大樓，建築

物包含地上八層及地下四層，樓地板面積達 27,000 平方公尺，將成為高通公司海外重要核心據點，也代表臺灣半導體產業鏈及整體投資環境業獲國際半導體領導廠商肯定及倚賴，高通公司與臺灣資通訊產業將進行深度合作，未來可更加速搶占全球商機，鞏固臺灣半導體產業占世界舉足輕重地位。